

合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	162,934.00	131,706.31	23.71
营业利润	42,243.44	32,985.53	28.07
利润总额	41,860.97	33,778.26	23.93
归属于母公司所有者的净利润	37,017.03	30,317.50	22.10
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	32,514.55	27,112.27	19.93
基本每股收益（元）	0.33	0.31	6.45
加权平均净资产收益率	7.56%	9.88%	减少 2.32 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	715,782.05	482,307.04	48.41
归属于母公司的所有者权益	582,863.46	322,324.51	80.83
股本	118,903.73	98,903.73	20.22
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	4.90	3.26	50.31

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2023 年年度报告为准，数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期经营状况

2023 年度，公司实现营业收入 162,934.00 万元，较上年度增长 23.71%；公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,017.03 万元，较上年度增长 22.10%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 32,514.55 万元，较上年度增长 19.93%。

2、报告期财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务状况良好，公司总资产 715,782.05 万元，较年初增长 48.41%；归属于母公司的所有者权益 582,863.46 万元，较年初增长 80.83%；归属于母公司所有者的每股净资产 4.90 元/股，较年初增长 50.31%。

3、影响经营业绩的主要因素

2023 年度显示驱动芯片及电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封装测试需求回暖，公司持续扩大封装与测试产能，不断提升产品品质及服务质量，加大对新客户开发的同时，持续增加新产品的开发力度，使得公司封装与测试收入保持较快增长。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因

1、本报告期末，公司总资产 715,782.05 万元，同比增长 48.41%，主要系 2023 年公司首次公开发行股票募集资金到位、应收款项及存货随业绩增长而正常增加，另因客户需求回暖，同时为建设合肥颀中先进封装测试生产基地，公司购买设备扩大产能，固定资产增加。

2、本报告期末，公司归属于母公司的所有者权益 582,863.46 万元，同比增长 80.83%，公司归属于母公司所有者的每股净资产 4.90 元，同比增长 50.31%，主要系 2023 年公司首次公开发行股票募集资金到位、经营产生的净利润使得对应的未分配利润增加所致。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日